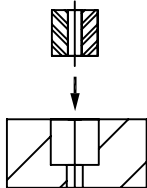
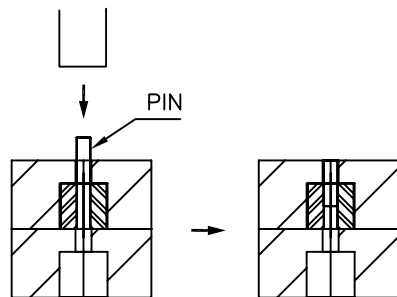


A

B



<STEP 3> 핀셋 이용하여 핀 삽입 후 가조립 (핀+절연체 가조립 시 지그 손으로 누름)
가조립 완료 후 지그 해체하여 핀 끝까지 누름

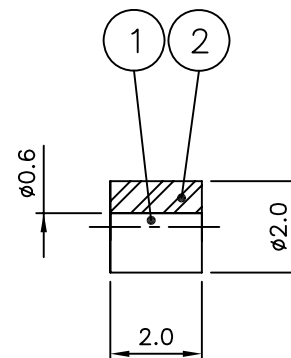


C

D

1. PIN과 절연체 조립 후 PIN 양끝단이 절연체 보다 돌출되지 않도록 주의 할 것.
2. PIN+절연체 조립시 헐겁지 않게 관리 필요.
(발주 진행 시 PIN 한도 견본을 절연체 외주 가공업체에 전달하여
조립 후 길이나 절연체가 헐겁지 않게 관리 될 수 있도록 내용 전달 필요.)

REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2020.09.24



2	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02927-N/4
1	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCT03914-5/4
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE 2020. 09. 24.			 KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
	Angle	APPROVED BY	I.C.KIM					
	$\pm 1^{\circ}$	CHECKED BY						
MATERIAL		DRAWN BY		S.Y.EUN		TITLE BUSHING		

FINISH		SCALE		UNIT				
_____		6/1		mm		A4	DWG NO. CN03890-7/2	
							REVISION	I R